

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT4484803

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT		
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT		
CONVEYING PARTY DATA			
	Name	Execution Date	
	HYOUNGHO KIM	06/27/2017	
	KWANGNAM SEO	06/27/2017	
	DOYOON KIM	06/27/2017	
RECEIVING PARTY DATA			
Name:	SOLID, INC.		
Street Address:	(SOLIDSPACE, SAMPYEONG-DONG) 220, PANGYOYEOK-RO, BUNDANG-GU		
City:	SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO		
State/Country:	KOREA, REPUBLIC OF		
Postal Code:	463-400		
PROPERTY NUMBERS Total: 1			
	Property Type	Number	
	Application Number:	15540494	
CORRESPONDENCE DATA			
Fax Number:			
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>			
Email:	dhunter@sughrue.com, sughrue@sughrue.com		
Correspondent Name:	SUGHRUE MION, PLLC		
Address Line 1:	2100 PENNSYLVANIA AVENUE NW		
Address Line 4:	WASHINGTON, D.C. 20037		
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	Q234026		
NAME OF SUBMITTER:	DARRYL M. HUNTER		
SIGNATURE:	/Darryl M. Hunter/		
DATE SIGNED:	06/29/2017		
	This document serves as an Oath/Declaration (37 CFR 1.63).		
Total Attachments: 3			
source=Q234026AssignmentwithDeclarationasfiled#page1.tif			
source=Q234026AssignmentwithDeclarationasfiled#page2.tif			
source=Q234026AssignmentwithDeclarationasfiled#page3.tif			

ASSIGNMENT WITH DECLARATION FOR PATENT APPLICATION (37 CFR 1.63)

특허 출원 관련 양도 및 선언 (연방규칙집 제 37 조 1.63 항)

Korean Language Assignment with Declaration

이하 알고인으로서 작성되는 허가 서명 발명자인 본인(들)은 아래에
정식된 출원에서 기술한 특정 개선을 발명하였으므로 그리고

제 소개한 (양수인)에게(은) 출원 및 발명의
그리고 이에 따라 특허권 일체의 미국 특허에 대한 모든 권리, 소유권
및 이익을 획득하기를 원하므로.

이제 대가를 위한 그 수단을 인정합니다.

상기 양도인인 본인(들)은 상기 명칭의 양수인, 그 승계가 및 그
양수인에게 모든 분할과 그 상속을 포함하여 미국 동으로 공개된
출원과 발명 그리고 그에 대해 승인될 수 있는 미국의 모든 특허증서와
미합중국 코드 제 35 장 제119항에 의거한 우선권 청구권과 과거의
출원에 대한 소송권을 포함한 모든 그 제발명에 대한 전체 권리,
소유권 및 이익을 판매, 양도 및 이전하여 그리고 본인(들)은 출원서에
제기된 발명에 대해 승인된 일체의 특허증서를 양수인, 그 승계자 또는
그 양수인에게 발급하도록 미국 특허청장에게 요청하는 바이며 또한
본인(들)은 양수인의 요청할 경우 미국 출원과 관련하여 양수인이
필요하다고 생각하는 모든 서류를 더 이상의 보수 없이 서명날인할
것입니다.

본인은 기록을 위해 요구되는 않지만 미합중국 코드 제 35 장
제262항에 의거 서명날인에 대한 일종의 증거입니다)

본인은 아래 명칭의 발명자로서 다음과 같이 선언합니다.

본 양도 및 선언서는 다음 사항을 위한 것입니다:

- ☐ 원부 출원 또는
☐ 미합중국 출원 또는 PCT
국제출원 번호: _____
출원일: _____ (확인 번호: _____)

본 출원의 제목은 다음과 같습니다:

Whereas, I/We, the undersigned inventor(s) hereinafter called
assignor(s), have invented certain improvements described in the
application identified below; and

Whereas, SOLID, INC. of (SolidSpace, Samyeong-dong) 220,
Pangyojeok-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 463-400,
Korea, (assignee), desires to acquire the entire right, title, and
interest in the application and invention, and to any United States
patents to be obtained therefor;

Now therefore, for valuable consideration, receipt whereof is
hereby acknowledged,

I/We, the above named assignor(s), hereby sell, assign and transfer
to the above named assignee, its successors and assigns, the entire
right, title and interest in the application and the invention
disclosed therein for the United States of America, including all
divisions, and continuations thereof, and all Letters Patent of the
United States that may be granted thereon, and all reissues thereof,
including the right to claim priority under 35 USC 119 and the
right to sue for past damages, and I/we request the Director of the
U.S. Patent and Trademark Office to issue any Letters Patent
granted upon the invention set forth in the application to the
assignee, its successors and assigns; and I/we will execute without
further consideration all papers deemed necessary by the assignee
in connection with the United States application when called upon
to do so by the assignee.

(Legalization not required for recording but is prima facie evidence
of execution under 35 USC 261)

As the below named inventor, I hereby declare that:

This assignment with declaration is directed to:

- ☒ The attached application, or
☐ United States Application or PCT International
Application Number _____ filed on
_____ (Confirmation No. _____).

The application is entitled:

APPARATUS AND METHOD FOR PROCESSING OUTPUT
SIGNAL OF ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER

Korean Language Assignment with Declaration

위에 표시된 출원은 본인에 의해 출원되거나 또는 인정되도록 허가된
것입니다.

The above identified application was made or was authorized to be
made by me.

본인은, 본인이 본 출원에서 청구된 발명의 원 발명자 또는 원 공동
발명자라고 믿습니다.

I believe that I am the original inventor or an original joint
inventor of a claimed invention in the application.

본인은 본 양도 및 선언서 제출과 관련된 출원의 내용을 검토하였으며
아름아 이해합니다.

I have reviewed and understand the contents of the application for
which this assignment with declaration is being submitted.

본인은 연방 규정 코드 제 37 장 제 1.56 항에 규정된 바에 따라,
특허청의 판단에 중요한 본인이 아는 모든 정보를 특허청에 공개할
의무가 있음을 알고 있습니다.

I am aware of the duty to disclose to the Office all information
known to me to be material to patentability as defined in
37 CFR 1.56.

본 양도 및 선언서 내에 허위적 허위 진술이 있을 경우, 내정종과 코드
제 18 장과 1001 항에 의거 원금이나 5년 이하의 징역 또는 두 가지
처벌은 모두 받을 수 있음을 인정합니다.

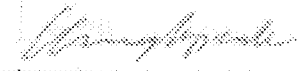
I hereby acknowledge that any willful false statement made in this
assignment with declaration is punishable under 18 USC 1001 by
fine or imprisonment of not more than five (5) years, or both.

STATEMENT OF ACCURATE TRANSLATION IN ACCORDANCE WITH 37 CFR 1.59(b):

The assignment with declaration is an accurate translation of the
corresponding English language assignment with declaration.

Signature

Date



March 17, 2014

NAME OF SOLE OR FIRST INVENTOR:

단독 발명자 또는 발명자의 성명

Given Name (first and middle (if any))

이름 (성씨를 제외)

Hyounggho

Family Name or Surname

성 (姓)

KIM

Inventor's signature

발명자의 서명

Date

일자

June 27, 2017

Residence:

거주지:

Seoul, Republic of Korea

Mailing Address:

우편 주소:

c/o SOLiD, INC., (SolidSpace, Sampyeong-dong) 220, Pangyo-eok-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 463-400, Korea

NAME OF SECOND INVENTOR:

두 번째 발명자의 성명

Given Name (first and middle (if any))

이름 (성씨를 제외)

Kwangnam

Family Name or Surname

성 (姓)

SEO

Inventor's signature

발명자의 서명

Date

일자

June 27, 2017

Residence:

거주지:

Guri-si, Republic of Korea

Mailing Address:

우편 주소:

c/o SOLiD, INC., (SolidSpace, Sampyeong-dong) 220, Pangyo-eok-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 463-400, Korea

NAME OF THIRD INVENTOR:

세 번째 발명자의 성명

Given Name (first and middle (if any))

이름 (성씨를 제외)

Doyeom

Family Name or Surname

성 (姓)

KIM

Inventor's signature

발명자의 서명

Date

일자

June 27, 2017

Residence:

거주지:

Bucheon-si, Republic of Korea

Mailing Address:

우편 주소:

c/o SOLiD, INC., (SolidSpace, Sampyeong-dong) 220, Pangyo-eok-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 463-400, Korea